

FL-Bond II

Système adhésif auto-mordançant à libération de fluor

FL-Bond II est un adhésif auto-mordançant en deux étapes qui procure une excellente adhérence sur émail et dentine ainsi qu'une étanchéité sûre des joints marginaux. Facile à manipuler, ce produit se distingue par une biocompatibilité améliorée. La viscosité modérée du FL-Bond II facilite son application et sa stabilité lui permet de ne pas couler en fond de cavité, le long des parois. Ainsi l'épaisseur du film reste constante sur toutes les surfaces enduites, garantissant une force de liaison stable.

Indications

- Collage de tout composite sur substrat dentaire
- Prétraitement de substrat dentaire avant application de ciment résine
- Réparation de restaurations

AVANTAGES

Manipulation simple et rapide en deux étapes

Viscosité et adhérence optimales

Radio-opacité pour des diagnostics précis

Absorption et libération de fluor

Force de liaison durable



Réf.	Quantité	Produit
1306	1 pce	FL-Bond II Kit Primer 5 ml, Bonding Agent 5 ml, MicroBrush rose et jaune, 25 pces. de chaque, godet, couvercle plastique
1307	5 ml	FL-Bond II Primer
1308	5 ml	FL-Bond II Bonding Agent (agent adhésif)
1309	6 ml	FL-Bond II Etchant (mordantage)

Usage

■ ETAPE 1 : PRIMER

Le Primer FL-Bond II contient un nouveau monomère adhésif ainsi qu'un photo-initiateur inédit. Le Primer auto-mordançant prépare les surfaces de dentine et d'émail, évitant l'étape acide phosphorique.

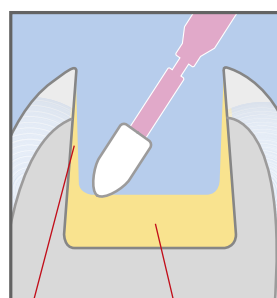
■ ETAPE 2 : COLLAGE

L'adhésif FL-Bond II contient des charges fluorées S-PRG (Surface Pre-Reacted Glaslonomer) qui offrent une protection permanente contre les caries secondaires, grâce à la reminéralisation du substrat dentaire environnant.

Doté d'un pourcentage de charge élevé, FL-Bond II présente une résistance à l'abrasion exceptionnelle, rassurante pour l'étanchéité des joints.

Faible viscosité

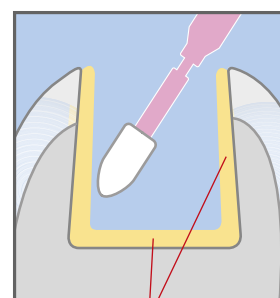
(Système standard)



Couche trop fine
Accumulation en fond de cavité

Viscosité modérée

(FL-Bond II)



Epaisseur restant uniforme

info

L'agent acide FL-Bond II Etchant sert en premier lorsqu'on utilise un système de collage auto-mordançant sur émail. Il contient de l'acide phosphorique dosé à seulement 7%.